**芯想未来，创见精彩，英特尔大连2023校园招聘火热进行中！**

**目标群体：**2023届或往届毕业生

**目标专业：**物理、化学、材料、电子/电气、机械、光学、力学、自动化、计算机、软件、大数据、通信、环境工程，能源动力、工业工程等理工科专业

**工作地点：**大连

**大连非易失性存储研发生产基地：**

英特尔大连工厂于2007年宣布建立，2010年正式投产65纳米逻辑芯片产品，是英特尔在亚洲的第一家晶圆制造厂，2015年宣布转产为“非易失性存储器（3D NAND）”制造，2018年成立研发（TD）团队。目前英特尔大连是集存储技术研发与制造一体化、全球领先的半导体公司之一，专注于非易失性存储半导体研发与制造，拥有来自11个国家的近五千名员工，其中硕士与博士人才占比超过40%。

2020年，英特尔与SK海力士达成协议，SK海力士收购英特尔的NAND闪存及存储业务，包括大连工厂，并预计将于2025年完成全部交易。目前，英特尔大连团队、SK海力士等紧密合作，正按计划推动新工厂建设，将大连工厂打造成具有国际竞争力的NAND闪存生产基地。

**岗位介绍：**

|  |  |
| --- | --- |
| 工艺工程师 | 属于工艺工程部门,包括光刻,刻蚀,薄膜,扩散及离子注入,化学机械研磨等部门. 主要职责是保证工艺的稳定性,找到不稳定因素,提出解决方案,提升良率,同时还需要解决线上各种异常问题,比如设备宕机等等,同时还需要做一些DOE (Design of experiment )实验,保证新机台,新部件的一致性等. |
| 设备工程师 | 主要职责是确保机台设备的良好运转,及时发现并解决与设备有关的问题. |
| 工艺整合工程师 | 对于芯片生产的整体工艺流程有一定的了解,确保产品经历多道不同工艺处理后能够达到预期的产品性能和要求；如有问题发生,需要利用相关团队资源来找出问题的症结点,最终解决问题. |
| 产品质量及可靠性工程师 | 对芯片在生产中的质量和芯片产品的可靠性负责,按照所规定的检验检测流程来对产品进行全程的品质管控和产品性能验证. |
| 厂务工程师  (水/电/气体/化学品/  机械/能源/环境健康安全等) | 负责整个工厂的水/电/气体/化学品/机械/能源等方面的配置和供应,并负责维护相关的设施,确保工厂能够24\*7顺利生产运行. |
| IT软件工程师 | 利用主流开发语言来开发和维护工厂自动化生产方面的应用软件,使其能更好支持晶圆厂的高效生产. |
| 测试  （嵌入式)工程师 | 利用自动化/嵌入式开发相关知识背景,来对芯片的测试程序进行开发优化和完善. |
| 制造工程部经理 | 管理为主、技术为辅的岗位,主要职责是带领15名以上员工,做好日常生产运营工作.该岗位具有灵活的个人工作休息时间,额外的翻班补助津贴.非常适合刚刚走出校门就希望能够带领团队锻炼自己领导能力的同学. |
| 研发 – 工艺及整合 | 负责3D NAND存储芯片的最新生产工艺的研发,新设备评估, 及N+1,N+2代产品架构定义,设计,验证,良率提升,电性优化.与量产部门合作将新产品导入至量产阶段. |
| 产品研发工程师 | 负责3D NAND新产品的研发设计与验证,以及提供相应测试方案.利用微电子/集成电路设计相关知识背景,协同其他部门解决NAND设计/测试/良率/可靠性等问题,并进行相应NAND产品电子性能优化. |

**网申方式：**

进入校招官网，选择心仪职位进行投递

<https://chinacampus.jobs.intel.cn/intel/position/index?recruitmentType=CAMPUSRECRUITMENT&baseProvinceCity=%E8%BE%BD%E5%AE%81%E7%9C%81-%E5%A4%A7%E8%BF%9E>

或者

关注“英特尔招聘在线”微信公众号，点击“芯职场”-“校园招聘”一键投递



**进校宣讲及面试日程**

<https://chinacampus.jobs.intel.cn/intel/home/index?page=campus>

**专业匹配**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **材料** | **机械工程** | **微电子** | **物理** | **能源与动力** | **环境** | **化学** | **电子信息与电气工程** | **光学** | **软件** | **自动化/控制科学与工程** | **数学科学** | **工程力学** |
| **工艺工程师 Process Engineer** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐** |
| **设备工程师 Equipment Engineer** | **⭐⭐** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐** |  | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐** |
| **工艺整合工程师工程师**  **Yield Integration Engineer** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐⭐** |  |  | **⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐** |  |
| **制造工程部经理 Manufacturing Engineering Manager** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐⭐** |
| **质量可靠性工程师**  **Quality & Reliability Engineer** | **⭐⭐** |  | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐⭐** |  |  | **⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐** |  |  |  |  |
| **晶圆/嵌入式测试工程师**  **Probe Test Engineer** |  |  | **⭐⭐** |  |  |  |  | **⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐⭐** |  |  |
| **自动化/软件工程师 Automation/Software Engineer** |  |  |  |  |  |  |  | **⭐⭐** |  | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐** |  |
| **厂务工程师(配电/水/气/机械/能源/环境健康安全） Facility Engineer** | **⭐⭐** | **⭐⭐⭐** |  |  | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐⭐** |  |  |  |  |  |
| **研发工艺及整合工程师**  **TD PE/PIE Engineer** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐** | **⭐⭐** |
| **产品研发工程师**  **Product Engineer** | **⭐⭐** |  | **⭐⭐⭐** | **⭐⭐** |  |  |  |  | **⭐⭐** | **⭐⭐** |  | **⭐⭐** |  |

**如有问题请邮件联系dalianhr@intel.com**